

주담대 20% 쌓일 때, 연체 120% 급증... ‘영끌족’ 부실 우려

주담대 채권 잔액 779조2000억
주담대 연체 채권 2조2000억 집계
장기 연체 1조4000억 수준 유지
고정하여신 1조7000억, 2배 ↑
6월 연체율 줄었지만 해소 신호 아나
취약 차주 등에 선제적 관리 필요

국내은행권의 주택담보대출 연체 채권이 가파르게 늘고 있다. 주택담보대출 잔액이 20%가량 증가하는 동안 연체 채권은 120% 급증했다. 특히 3개월 이상 장기 연체와 부실 가능성이 높은 고정하여신도 크게 늘면서 ‘영끌’(영혼까지 끌어모음) 차주를 중심으로 가계대출 부실이 확대될 수 있다는 우려가 나온다.

8일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 국내 은행의 주택담보대출 채권 잔액은 2022년 말 644조3000억원에서 올해 6월 말 779조2000억원으로 20.9% 증가했다. 반면 같은 기간 1개월 이상 원리금이 연체된 주택담보대출 연체 채권은 1조원에서 2조2000억원으로 120% 급증했다. 대출 잔액 증가율보다 연체 채권 증가율이 약 6배 높은 셈이다.

주담대 연체 채권은 매년 증가세를 이어가고 있다. 2023년 말 1조6000억원에서 2024년 말 1조9000억원, 지난해 말 2조1000억원으로 늘었고 올해 상반기에만 1000억원 증가했다.

장기 연체도 심상치 않다. 3개월 이상



주택담보대출이 크게 늘어난 가운데 연체율이 상승한 것으로 나타났다. 한 시중은행 창구에서 고객들이 상담하고 있다. /뉴시스

연체된 주담대 채권은 2022년 말 5000억원에서 2023년 말 9000억원, 2024년 말 1조1000억원, 지난해 말 1조4000억원으로 급증했다. 올해 6월 말에도 1조4000억원 수준을 유지했다. 단순히 일시적으로 상황이 지연된 차주뿐 아니라 상환 능력이 약화된 차주가 늘고 있다는 의미로 해석될 수 있다.

부실 가능성이 높은 대출도 증가했다. 고정·회수이문·주정손실 여신을 합한 고정하여신은 2022년 말 8000억원에서 올해 6월 말 1조7000억원으로 2배 이상 늘었다. 이에 따라 은행권의 손실흡수능력 확충 부담도 커졌다. 주담대 관련 대손충

당금은 같은 기간 3000억원에서 9000억원으로 3배 증가했다. 대손충당금을 고정하여신으로 나눈 적립률 역시 44.5%에서 51.1%로 상승했다.

은행별로는 NH농협은행의 주담대 연체 잔액이 가장 많았다. 올해 6월 말 5117억3000만원으로 5000억원을 처음 넘어섰다. KB국민은행이 3680억2000만원, 우리은행 3419억6000만원, 하나은행 3026억6000만원, 신한은행 2168억8000만원으로 뒤를 이었다. 농협은행의 연체 잔액은 2022년 말 1346억1000만원에서 4년이 채 안 되는 기간에 약 3.8배로 증가했다.

지방은행에서는 연체율 급등 사례도 나

타났다. 전북은행의 주담대 연체율은 지난해 말 0.19%에서 올해 6월 말 0.95%로 6개월 만에 5배 뛰었다. 금융감독원은 일부 신규 분양주택 집단대출에서 거액의 연체가 발생한 영향으로 설명했다. 경남은행도 같은 기간 0.14%에서 0.41%로, Sh수협은행은 0.17%에서 0.45%로 상승했다. 반면 신한은행은 0.19%, 카카오펜크는 0.16%로 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

다만 전체 은행권 연체율만 놓고 보면 최근 흐름은 다소 엇갈린다. 금감원에 따르면 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율은 0.56%로 전월보다 0.11%포인트(p) 하락했다. 가계대출 연체율도 0.40%로 0.

05%p 떨어졌으며 주택담보대출 연체율은 0.28%로 전년 동월보다 0.02%p 낮아졌다.

그러나 이를 부실 위험이 해소된 신호로 보기는 어렵다. 6월 중 신규 연체 발생액은 2조6000억원에 달했지만 은행권의 연체채권 정리 규모가 5조3000억원으로 크게 늘면서 연체율을 끌어 내렸기 때문이다. 금감원도 분기 말 연체채권 상·매각 확대가 6월 연체율 하락의 주요 요인이라며 경제 불확실성이 커질 경우 연체율이 다시 상승할 가능성이 있다고 밝혔다.

결국 관건은 주택가격과 금리, 그리고 차주의 상환능력이다. 대출금리가 높은 수준에서 유지되거나 소득 증가세가 둔화하면 변동금리 주담대와 과도한 레버리지를 활용한 차주의 부담이 커질 수 있다. 특히 집단대출과 다중채무자, 소득 대비 원리금 상환 부담이 큰 차주에 대한 선제적인 관리가 필요하다는 지적이 나온다.

박성훈 의원은 “가계의 빚 상환 능력이 대출 증가 속도를 따라가지 못하고 있다”며 “금융당국이 취약 차주와 집단대출 부실 위험을 선제적으로 점검해야 한다”고 주문했다.

은행권 역시 연체채권 관리와 대손충당금 확충을 통해 손실흡수능력을 높이는 동시에 취약 차주의 채무조정과 부실채권 정리를 병행할 필요가 있다는 지적이다.

/나유리 기자

yul115@metroseoul.co.kr



metro

키옥시아도 참전... 삼성·SK, CXL 메모리 선점 속도

(컴퓨터익스프레스링크)

키옥시아, XL-FLASH 결합 제품 공급
삼성전자, CXL 3.2 기반 ‘MD310’
SK, 서버-GPU 메모리 공유 기술 선보

인공지능(AI) 추론 확대에 대응할 메모리 수요가 늘어날 가능성에 대비해 글로벌 메모리 업체들이 컴퓨터익스프레스링크(CXL) 기술 개발에 속도를 내고 있다. 시장 확대까지는 시간이 필요한 단계로 평가되지만 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 일본 키옥시아도 관련 제품 개발에 나서며 차세대 시장을 겨냥한 움직임이 이어지고 있다.

8일 업계와 외신에 따르면 일본 낸드플래시 업체 키옥시아는 최근 자사 기술 브리핑에서 조만간 주요 고객사에 CXL 메모리 모듈의 샘플 공급을 시작할 계획이라고 밝혔다. 저지연 플래시메모리 ‘XL-



SK하이닉스의 컴퓨터익스프레스링크(CXL) 2.0 기반 D램 솔루션 CMM(CXL 메모리 모듈)-DDR5 96GB 제품. /SK하이닉스

FLASH’와 전용 컨트롤러를 결합한 제품이다.

키옥시아가 공개한 시뮬레이션에서는 D램의 3분의 1을 CXL 모듈로 대체해도 성능 저하가 5% 미만에 그쳤다. 같은 비용을 기준으로 D램 일부를 CXL 모듈로 바꾸면 메모리 용량을 2배로 늘릴 수 있다는 설명이다.

CXL은 중앙처리장치(CPU)와 그래픽

처리장치(GPU), 메모리 등을 고속으로 연결하는 인터페이스다. 여러 장치가 메모리를 공유할 수 있어 AI 서버의 메모리 용량을 확장하는 기술로 주목받고 있다.

특히 생성형 AI는 대화가 길어지고 동시 이용자가 늘어날수록 앞서 처리한 정보를 저장하는 ‘KV캐시’ 용량도 증가한다. 빠른 처리가 필요한 데이터는 고대역 폭메모리(HBM)에 두고 대용량 KV캐시는 CXL을 통해 외부 메모리로 확장하는 방식이 대안으로 거론된다.

국내 메모리 업체들도 AI 추론 과정에서 발생하는 메모리 병목을 줄이기 위해 CXL 활용 범위를 넓히고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 지난 8월 4부터 6일까지 미국 캘리포니아주 산타클라라에서 열린 메모리·스토리지 전시 컨퍼런스 ‘FMS2026’에서 관련 제품과 기술을 대거 공개했다.

삼성전자는 행사에서 차세대 CXL D램 제품인 CMM-D(CXL Memory Module-D) ‘MD310’을 전시했다. CXL 3.2와 PCIe 6.0을 지원하며 여러 호스트가 하나의 메모리 풀을 공유하고 필요에 따라 용량을 할당할 수 있다.

AI 추론에 CXL을 적용한 연구에서도 성능 개선 가능성을 확인했다. 삼성전자 연구진의 실험 결과 긴 문맥을 처리하는 환경에서 CXL 기반 D램을 활용한 추론 처리량은 GPU 메모리만 사용한 경우보다 최대 9배 높았다. 첫 번째 토큰 생성시간은 최대 16분의 1 수준으로 줄었다.

SK하이닉스는 FMS2026에서 여러 서버와 GPU가 메모리를 공유하는 CXL 기반 ‘Pooled Memory’ 기술을 선보였다. 분산된 AI 시스템에서 KV캐시를 CXL 메모리를 통해 전달·재사용해 데이터 이

동 과정에서 발생하는 병목을 줄이는 방식이다.

D램과 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 결합한 ‘CMM-Hybrid’도 공개했다. 대용량 데이터는 SSD에 저장하고 필요한 데이터는 D램으로 미리 옮겨 처리해 두 메모리의 용량과 속도를 함께 활용한다.

SK하이닉스는 미국 반도체기업 마벨과 CXL 기반 PNM(Processing-Near-Memory) 솔루션 ‘CMM-Ax’도 개발했다. 메모리 주변에서 일부 연산을 처리해 데이터 이동을 줄이는 기술로, 장문 기반 대규모언어모델(LLM) 추론을 겨냥한다.

업계 관계자는 “CXL은 서버 교체 주기와 소프트웨어 최적화 등을 고려하면 시장 확대까지 시간이 필요한 상황”이라며 “다만 향후 에이전트 AI 확산으로 처리해야 할 데이터가 늘어날 경우 대용량 메모리 수요와 함께 CXL 활용도도 점차 높아질 것”이라고 말했다.

/차현정 기자 hyeon@



metro

삼성전자-ASML, 12인치 포토마스크로 생산성 40% 높인다

‘대형 마스크 컨소시엄 사업’ 참여
처리 영역 넓히고 스티칭 작업 줄여

삼성전자가 세계 최대 반도체 노광장비 기업 ASML과 차세대 반도체 제조 기술 개발에 나선다. 반도체 회로를 새기는 데 사용하는 포토마스크를 기존 6인치에서 12인치로 키워 생산성을 높이고, 2028년에는 업계 최초로 첨단 D램 생산에 차세대 극자외선(EUV) 장비를 적용할 계획이다.

삼성전자는 ASML이 주도하는 ‘대형 마스크 컨소시엄’(Large Size Mask Consortium)에 참여해 차세대 12인치 포토마스크 공동 개발에 나선다고 8일 밝혔다. 참여 기업들은 관련 기술을 공동 연구하고 12인치 마스크 표준 개발을 추진한다.

포토마스크는 반도체에 새길 미세 회로 패턴을 담은 원판으로 회로의 ‘설계도’ 역할을 한다. 현재 주로 사용하는 6인치 마스크를 12인치로 키우면 한 번에 더 넓은 영역의 회로를 처리할 수 있다.

12인치 마스크 도입은 차세대 노광장비인 ‘하이 NA’(High-NA) 극자외선(EUV)의 생산성을 높이기 위해서다. 하이 NA EUV는 기존 EUV보다 더 미세한 회로를 그릴 수 있지만 한 번에 회로를 새길 수 있는 면적은 절반 수준이다. 이에 대형 반도체는 회로를 나눠 새긴 뒤 연결하는 ‘스티칭’(Stitching) 작업을 거쳐야 해 공정이 복잡해질 수 있다.

마스크 크기를 12인치로 키우면 한 번에 처리하는 영역을 넓혀 스티칭 작업을

줄일 수 있다. ASML은 이를 통해 대형 첨단 반도체에도 하이 NA EUV를 효율적으로 활용해 생산성을 최대 40% 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 AI 반도체처럼 칩 크기가 커질수록 효과가 커질 것으로 예상된다.

글로벌 반도체 업계도 관련 기술 개발에 나섰다. ASML과 TSMC는 이날 2031년 12인치 마스크 시험 생산라인을 구축하고 2033년 첨단 공정에 적용할 수 있는 노광 시스템을 갖춘다는 계획을 공개했다. 삼성전자도 개발 단계부터 컨소시엄에 참여 관련 기술과 표준 개발에 나선다.

삼성전자는 하이 NA EUV를 첨단 D

램 생산에도 적용한다. ASML과 협력해 2028년 업계 최초로 첨단 D램 생산에 하이 NA EUV 장비를 도입할 계획이다. D램 회로가 미세해질수록 기존 EUV로는 여러 차례 공정을 거쳐야 하지만 하이 NA EUV를 활용하면 일부 공정을 줄여 생산성을 높일 수 있다.

양사는 초미세 반도체 공정을 중심으로 협력을 이어왔다. 2023년에는 차세대 EUV 기반 초미세 공정 공동 연구시설 구축에 합의했다. 이번에는 하이 NA EUV와 12인치 마스크까지 협력 범위를 넓혔다.

/구남영 기자 koogija_tea@



metro